

2019 年 1 月 10 日

「第 5 回 ウェアラブル EXPO」にフィルム状導電素材を出展

当社グループは、1 月 16 日(水)から 18 日(金)の 3 日間、東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催されるウェアラブル端末の活用と技術の総合展「第 5 回 ウェアラブル EXPO」に出展します。ウェアラブルデバイス用のフィルム状導電素材「COCOMI®」をさまざまな活用例とともに展示します。



「COCOMI®」を使用した電極、配線パターンサンプル



さまざまなシーンに対応したスマートテキスタイル製品

1. 会 期: 2019年1月16日(水)~18日(金) 10:00 ~ 18:00

※18日(金)は17:00で終了

2. 会 場: 東京ビッグサイト(東京都江東区)

3. ブースナンバー: W16-16

4. 「ウェアラブル EXPO」について:

最新のウェアラブル端末から、活用ソリューション、AR/VR技術、最新ウェアラブルデバイス開発のための部品・材料まで、ウェアラブルに関する全てが出展される、世界最大規模の展示会です。年に1回開催され、今回で5回目を迎えます。

5. 出展製品:

○ フィルム状導電素材「COCOMI®」

ウェアラブルデバイス用の電極・配線材向けのフィルム状の導電素材です。薄く、伸縮性に優れるため、体の動きに追従できるほか、電極と配線が継ぎ目なく一体化していることにより、自然な着心地のウェアラブルデバイスを実現できます。また、「COCOMI®」を使用した配線は電気抵抗値が低く、精度の高い生体情報の収集が可能です。

【主な展示内容】

① 「COCOMI®」を使用した電極、配線パターンのサンプル

② ワーキングやホームテキスタイル、カジュアル、スポーツなど、さまざまなシーンに対応するスマートテキスタイル製品

③ 「COCOMI®」を使用した「スマートセンシングウェア®」ができるまでの工程や中間材料
「COCOMI®」を使用したウェアを着用した説明員が、生体情報をリアルタイムで計測できる様子を実演します。

当社は、文部科学省の「革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)拠点」事業の「運動の生活カルチャー化により活力ある未来をつくるアクティブ・フォー・オール拠点」(中核拠点:立命館大学)に参画。本技術の一部を提供するとともに、成果の一部を使用しています。

以 上

<お問い合わせ先>

東洋紡株式会社

コーポレートコミュニケーション部

電話:06-6348-4210 FAX:06-6348-3443

e-mail:pr_g@toyobo.jp